

スプレー装置対応樹脂上パラジウム残渣除去液

OPCパラデリートIF

Palladium Residue Removing Solution, Can Use by Spraying

OPC PALLADELETE IF

- スプレー装置に対応
- レジストへのアタックが少ない硫酸-過酸化水素水タイプの酸性除去液
- シアン、ヨウ素化合物を用いていない
- 薬液の分析管理が可能

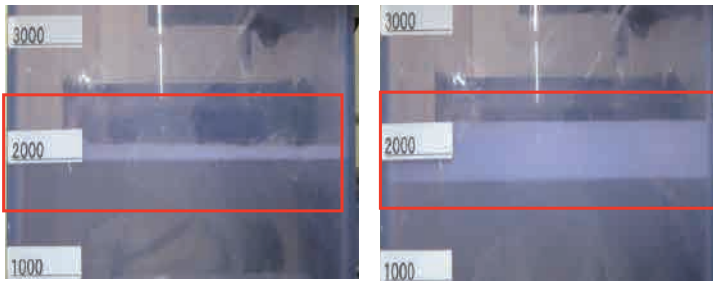
- Can use by spraying
- H₂O₂-H₂SO₄ base, acidic solution to remove Pd residues without damaging resists
- Cyanide-, iodine-free
- Can control bath by analysis

スプレー処理に対応

Applicable to spray treatment

従来浴よりも発泡性を抑制し
スプレー処理が可能

Prevent foaming, can use by spraying



OPCパラデリートIF
OPC PALLADELETE IF

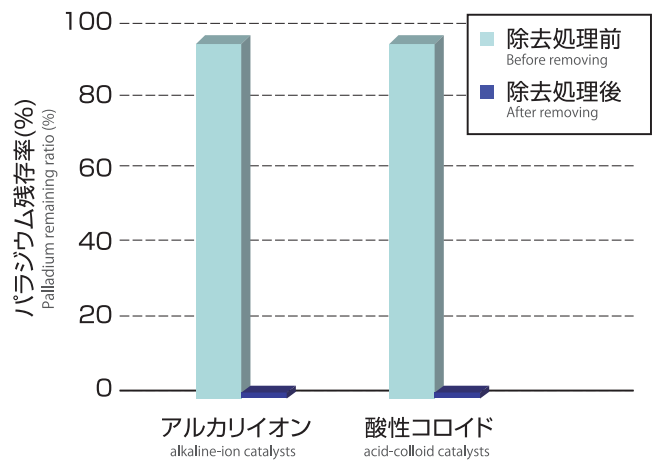
従来浴
Conventional bath

優れた触媒残渣除去性

Excellent in palladium residue removing performance

酸性コロイド、アルカリイオン触媒
いずれの除去も可能

Can use for acid-colloid and alkaline-ion catalysts



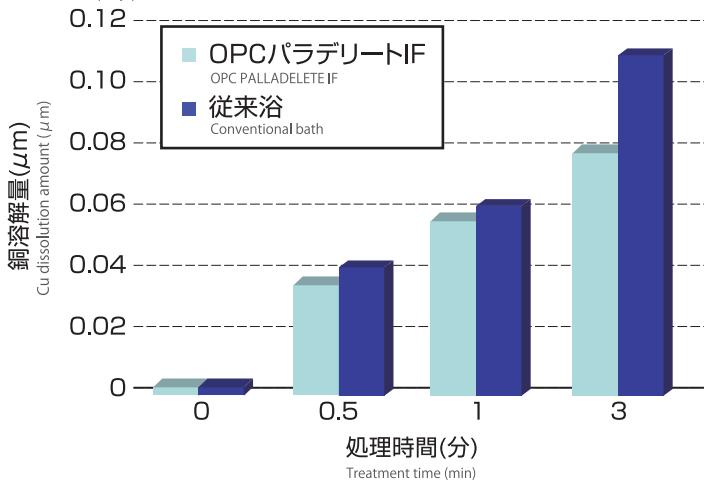
少ない銅溶解量

Reduce copper dissolution amount

銅溶解量が少なく、微細配線へ適応可能

Reduce copper dissolution amount, suitable for ultra-fine patterning

※スプレー圧: 0.15MPa
Spray pressure: 0.15MPa



良好なパターン性

Excellent in pattern forming performance

